



# SMTA China East 华东高科技会议 Technical Conference

**24<sup>th</sup> April 2018 (Tuesday) / 2018 年 4 月 24 日(星期二)**

<b>(CE18-TC1) Technology Conference / 高科技技术研讨会</b>		
<b>Conference Chairman/会议主席:</b> Lin Dong 董林 Member of SMTA China Technical Advisory Committee / 中国 SMTA 技术顾问委员会委员 Section Manager, SMT Engineering of Artesyn Embedded Technologies 雅特生科技表面贴装工程部经理		
<b>Venue/地点</b>	Room No.6, B2, Shanghai World Expo Exhibition & Convention Center 上海世博展览馆地下二层 6 号会议室	
<b>Time/时间</b>	<b>Topic/主题</b>	<b>Speaker/演讲者</b>
10:30 – 11:05	Differences Between SMD and NSMD In SMT Process SMD 与 NSMD 在表面贴装工艺中的差异 (CE18-TC1.1)	Evan Yin 殷雪冬 Indium Corporation (Suzhou) Co., Ltd. 镉泰科技(苏州)有限公司
11:05 – 11:40	Flux Amount Control for Consistent Process Quality 助焊剂流量控制对于制程品质稳定 (CE18-TC1.2)	Kar Heong Khoh 许教雄 ITW EAE 依工电子设备
11:40 – 12:15	Assessing The Effectiveness of I/O Stencil Aperture Modifications On BTC Void Reduction 关于修改 I/O 钢网孔径以减少 BTC 上的空洞的有效性评估 (CE18-TC1.3)	Derek Wang 王勇 AIM Solder (Shenzhen) Company Limited 华加美焊材(深圳)有限公司
12:15– 13:45	<b>Lunch Break / 午餐</b>	
13:45 – 14:20	Cleaner Concentration Monitoring for High-Reliability Electronics 高可靠性电子清洗工艺中的浓度监控 (CE18-TC1.4)	Jerry Ji 纪建光 ZESTRON Asia North ZESTRON 北亚分公司
14:20 - 14:55	Sn3.2Ag0.7Cu5.5Sb Solder Alloy With High Reliability Performance Up To 175°C 用于高工作温度 (175°C) 的新型高可靠性合金 90.6Sn3.2Ag0.7Cu5.5Sb (CE18-TC1.5)	Mary Ma 马丽 Indium Corporation (Suzhou) Co., Ltd. 镉泰科技(苏州)有限公司
14:55 - 15:30	How Your Factory Will Become Smart With CIM and IoT 智能工厂的必由之路- IoT 与 CIM (CE18-TC1.6)	Toby Jiang 江涛 Mentor Graphics(Shanghai) Electronic Co., Ltd. 明导(上海)电子科技有限公司

All papers will be presented in Chinese 所有演讲者都将使用中文



# SMTA China East 华东高科技会议 Technical Conference

**25<sup>th</sup>** April 2018 (Wednesday) / 2018 年 4 月 25 日(星期三)

<b>(CE18-TC2) Technology Conference / 高科技技术研讨会</b>		
<b>Conference Chairman/会议主席:</b> Henley Zhou 周辉 Member of SMTA China Technical Advisory Committee / 中国 SMTA 技术顾问委员会委员 Director of Advanced Manufacturing Engineering, Asia of Flex 伟创力亚洲区先进制造工程部总监		
<b>Venue/地点</b>	Room No.6, B2, Shanghai World Expo Exhibition & Convention Center 上海世博展览馆地下二层 6 号会议室	
<b>Time/时间</b>	<b>Topic/主题</b>	<b>Speaker/演讲者</b>
10:30 – 11:05	Low Temperature Soldering Using SN-BI Alloys 锡铋(SN-BI)合金低温焊接应用 (CE18-TC2.1)	William Yu 余瑜 Alpha Assembly Solutions 爱法组装机材料
11:05 – 11:40	Fluxes Effective In Suppressing Non-Wet-Open At BGA Assembly 通过助焊剂有效地抑制 BGA 组装中的 NWO 缺陷 (CE18-TC2.2)	Alice Zhou 周凤颖 Indium Corporation (Suzhou) Co., Ltd. 镉泰科技(苏州)有限公司
11:40 – 12:15	The Study of Correlation Between Wave Flux Physical Properties and Its Effect To The Overall Wave Soldering Performance 关于波峰助焊剂的物理特性对波峰焊接效果和可靠性之间的关联性研究 (CE18-TC2.3)	Henley Zhou 周辉 Flex 伟创力
12:15 – 13:45	<b>Lunch Break / 午餐</b>	
13:45 – 14:20	Cleaning No Cleans and Other Contaminants 清洗免洗型和其它污染物 (CE18-TC2.4)	Daniel Gao 高伟 Kyzen Corporation 美国 Kyzen 公司
14:20 - 14:55	Qualification Test Development for Creep Corrosion By Using Flower-Of-Sulfur (FOS) Methodology 使用硫华(FOS)方法进行爬行腐蚀之验证试验的开发 (CE18-TC2.5)	Dem Lee 李易展 Integrated Service Technology Inc. 宜特科技股份有限公司
14:55 - 15:30	The Study of The Chassis and PCBA Mounting Screws Effective Engagement 关于机箱与 PCBA 间固定螺丝有效咬合的研究 (CE18-TC2.6)	Patton Dong 董昭平 Jabil Circuit (Wu Xi) Co.,Ltd. 捷普电子无锡有限公司

All papers will be presented in Chinese 所有演讲者都将使用中文

Fee / 收费: RMB300/per day (including official invoice) / 人民币 300 元/天(包含发票)

Noted: 1. RMB285/per day for registering before 31 March and RMB540/two days for registering before 31 March  
2. Deadline for registration and Conference Fee Collection is 21 April

注: 1. 在 3 月 31 日前登记会议可享受 9.5 折的优惠价(人民币 285 元)  
同时报名登记 2 天的会议可享受 9 折的优惠价(人民币 540 元)  
2. 报名和收款截止日期是 4 月 21 日

Offer / 提供: 1. SMTA China Technology Conference Attendance Certificate / 中国 SMTA 高科技技术研讨会出席证书  
2. Electronic Version of Conference Proceedings / 电子版本的论文集  
3. Free Lunch Coupons / 免费午餐券

查询及报名: 电邮至 [peggychen@smta.org.cn](mailto:peggychen@smta.org.cn), 电话: +86 -21-56093010, 手机: +86-18202193148